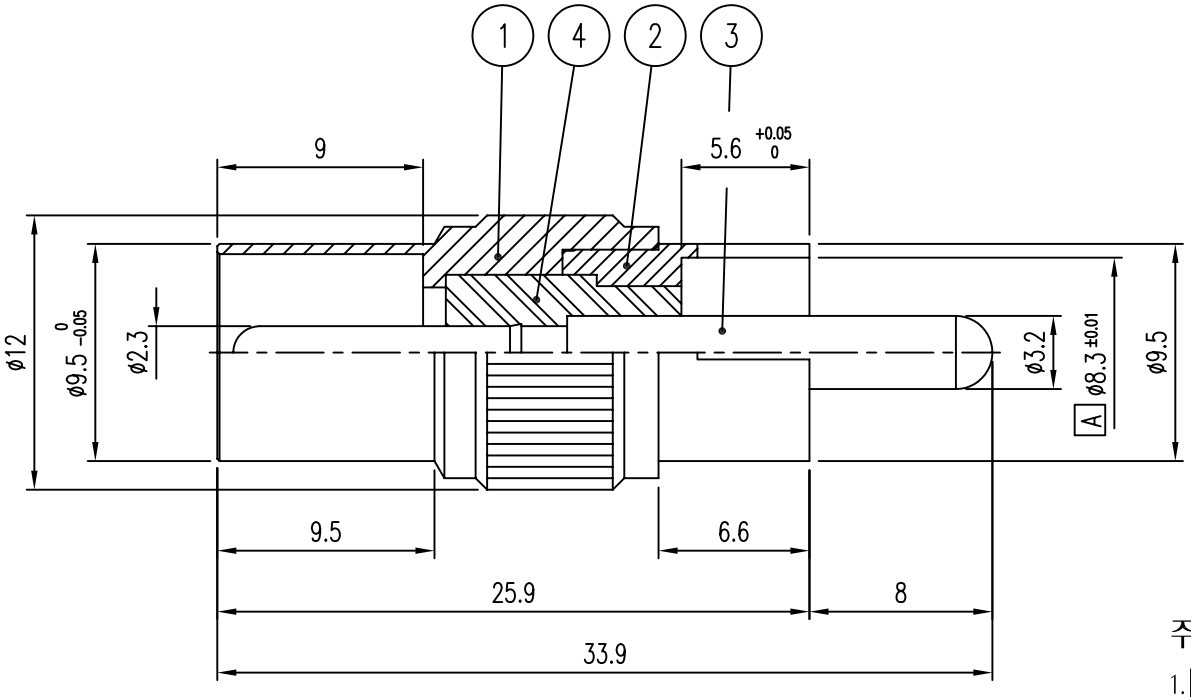
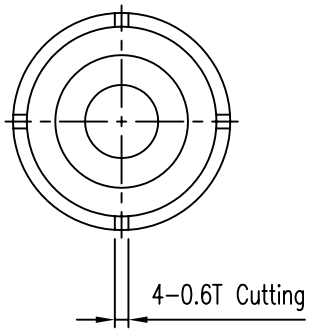
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

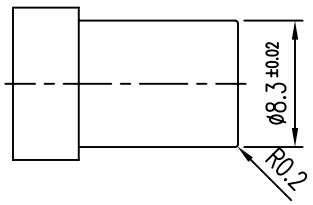
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	재질변경 및 공차변경	손윤호	길준범	2004. 11. 9.





주 기

1. A 부위 특별관리 상대물과 형합시 삽입력 1.5~3Kgf관리.



A 상대물 치수

품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
4	INSULATOR	1	ACETAL MOLD		DAI00049-N/1 (HA206)
3	CONTACT	1	MBsBD (MB20-무연봉)	Nickel Plate	DAC00084-5/1 (EA232)
2	BODY	1	MBsBD (MB20-무연봉)	Nickel Plate	DBD01254-5/1 (DA263)
1	BODY	1	MBsBD (MB20-무연봉)	Nickel Plate	DBD01253-5/1 (DA262)

적용업체	삼성전자	년월일	2004. 9. 14.
업체코드	3705-001361	승인	
		검도	
		제도	
		검도	
		작성부서	연 구 소
		척도	5/1
		단위	mm
		중량	—

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 DINP-RCAP

A4

도번 AD00209-7/1

K361-991-002